

SAMPE JAPAN 会員各位殿

コンポジット委員会 第70回研究会のご案内

SAMPE Japan コンポジット委員会

拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

日頃は当協会の活動にご支援、ご協力を賜りまして、心より御礼申し上げます。

このたび、コンポジット委員会の記念すべき、「第70回研究会」を下記の通り開催することになりました。つきましては、ご参加いただき、積極的なご討論のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時： 2020年3月27日(金)13時00分～19時00分

場 所： 同志社大学今出川校地(室町キャンパス) 寒梅館 ハーディーホール
〒602-0023 京都市上京区烏丸上立売下ル

申込み： 準備の都合上、3月16日(月)までに、お申し込みください。

申込み先： SAMPE Japan コンポジット委員会事務局

(FAX:0773-62-8939、E-Mail: sinohara@maizuru-ct.ac.jp)

参加費： 会員 ¥8,000、非会員 ¥12,000

お支払方法： 研究会当日、受付にて現金でお支払いをお願いします。

【プログラム】

<13:00-13:10>

開会の辞 コンポジット委員会 委員長

シキボウ(株) 田那村 武司

<13:10-14:00>

1. 「産業用ドローンと空飛ぶ車の技術動向、複合材料に期待する技術」

(株)プロドローン 菅木 紀代一

<14:00-14:50>

2. 「JEC world (Paris) 2020 の報告1」
(概要とJEC Award について)

金沢工業大学 鶴澤 潔

<14:50-15:10>休憩

<15:10-16:00>

3. 「JEC world (Paris) 2020 の報告2」
(熱可塑性コンポジットを中心に)

福井大学 山根 正睦

<16:00-16:30>

4. 「JEC world (Paris) 2020 の報告3」
(複合材料自動化設備を中心に)

(株)KADO 倉谷 泰成

<16:30-17:20>

5. パネルディスカッション

「JEC World 2020 から見る最新の技術トレンドと日本はこれからどうするべきか」

ファシリテーター:シキボウ(株):田那村 武司

先端材料技術協会

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨 1-24-1・4F (株) ガリレオ内

Tel:03-5981-9824 Fax:03-5981-9852 E-mail:g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

パネラー: (株)日本モールドシステム:酒谷 芳秋、丸八(株):菅原 寿秀、
 (株)KADO:倉谷 泰成、(株)マジックボックス JP 柳原 淳一、
 金沢工大:鶴澤 潔、福井大学:山根 正睦、同志社大学:田中 和人

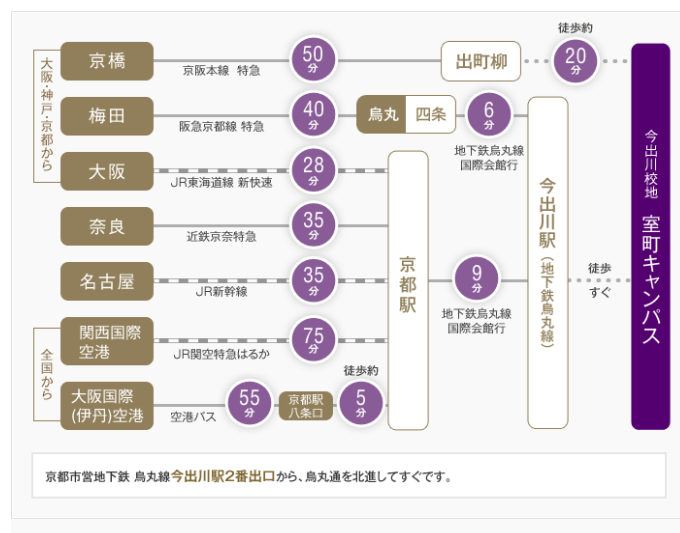
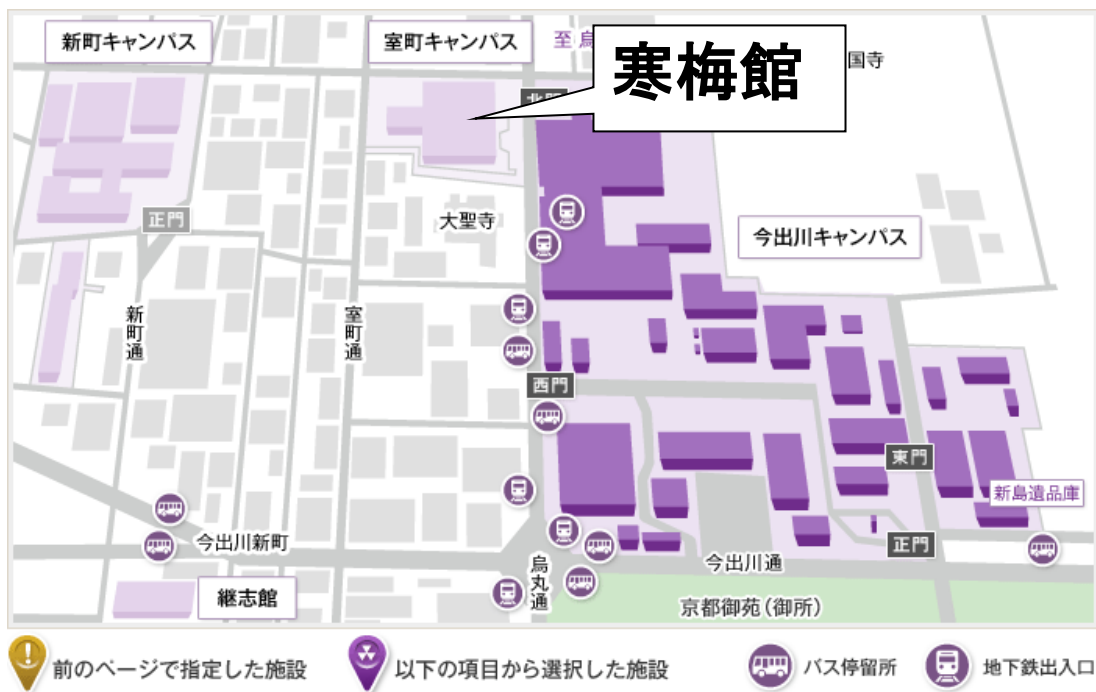
<17:30-19:00>

情報・名刺交換会 寒梅館 1階 Hamac de Paralid(アマーク・ド・パラディ)

以上

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>





Society for the Advancement of Material and Process Engineering

先端材料技術協会

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1 4F (株) ガリレオ内

Tel:03-5981-9824 Fax:03-5981-9852 E-mail:g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

コンポジット委員会 第70回研究会 参加申込用紙

SAMPE Japan コンポジット委員会事務局
(FAX:0773-62-8939、E-Mail: sinohara@maizuru-ct.ac.jp)

参加申込締め切り: 2020年3月16日(月)

・コンポジット委員会 第70回研究会に参加します。

・情報・名刺交換会(17:30-19:00)に【参加します. 参加しません.】

[いずれかを消して下さい]

会社名:

所属:

郵便番号:

TEL:

住所:

FAX:

氏名:

E-mail: